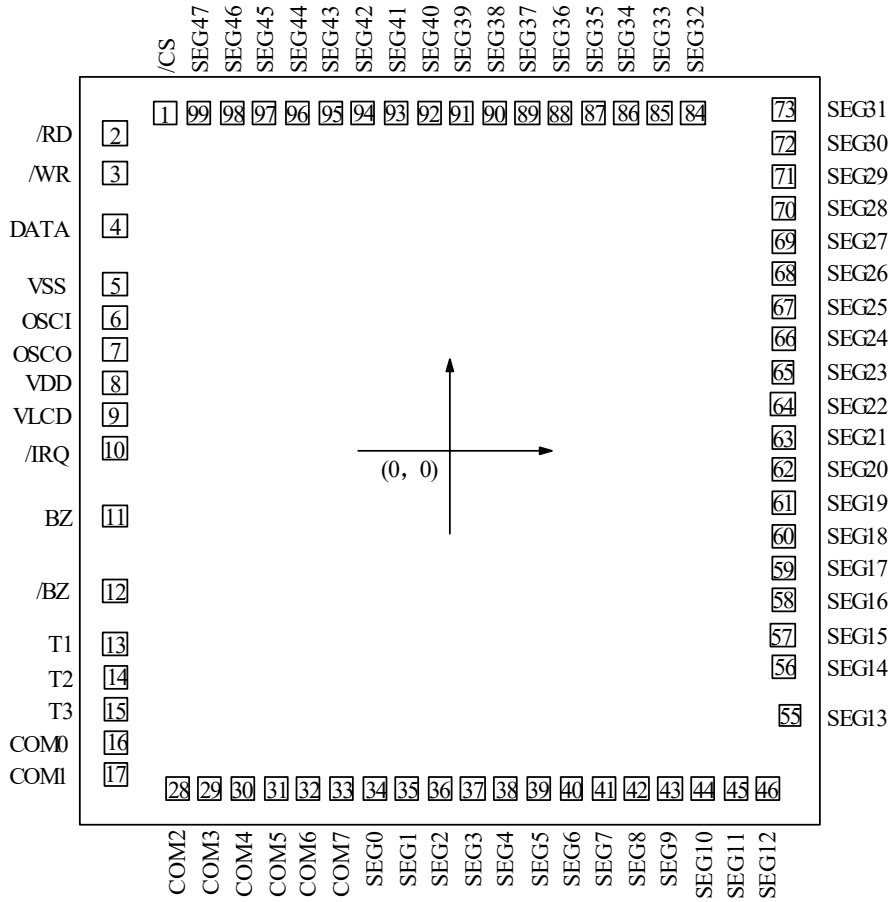


VK1623 COB资料

COBPAD图



芯片面积: 2730×2730 um² , 衬底电位: VDD

PAD 大小: 90×90 um, 间距: 112 um, 铝垫大小: 100×100 um, 铝垫厚度: 1um

COB PAD坐标

(坐标原点在芯片中心, 单位: μm)

序号	名称	X坐标	Y坐标	序号	名称	X坐标	Y坐标
1	/CS	-1076	1288	51	NC	—	—
2	/RD	-1270	1212	52	NC	—	—
3	/WR	-1270	1062	53	NC	—	—
4	DATA	-1270	860	54	NC	—	—
5	VSS	-1270	638	55	SEG13	1293	-1008
6	OSCI	-1270	513	56	SEG14	1270	-823
7	OSCO	-1270	388	57	SEG15	1270	-698
8	VDD	-1270	263	58	SEG16	1270	-573
9	VLCD	-1270	138	59	SEG17	1270	-448
10	/IRQ	-1270	13	60	SEG18	1270	-323
11	BZ	-1270	-249	61	SEG19	1270	-198
12	/BZ	-1270	-534	62	SEG20	1270	-73
13	T1	-1270	-738	63	SEG21	1270	51
14	T2	-1270	-863	64	SEG22	1270	176
15	T3	-1270	-988	65	SEG23	1270	301
16	COM0	-1270	-1113	66	SEG24	1270	426
17	COM1	-1270	-1238	67	SEG25	1270	551
18	NC	—	—	68	SEG26	1270	676
19	NC	—	—	69	SEG27	1270	801
20	NC	—	—	70	SEG28	1270	926
21	NC	—	—	71	SEG29	1270	1051
22	NC	—	—	72	SEG30	1270	1176
23	NC	—	—	73	SEG31	1270	1301
24	NC	—	—	74	NC	—	—
25	NC	—	—	75	NC	—	—
26	NC	—	—	76	NC	—	—
27	NC	—	—	77	NC	—	—

序号	名称	X坐标	Y坐标	序号	名称	X坐标	Y坐标
28	COM2	-1035	-1288	78	NC	—	—
29	COM3	-910	-1288	79	NC	—	—
30	COM4	-785	-1288	80	NC	—	—
31	COM5	-660	-1288	81	NC	—	—
32	COM6	-535	-1288	82	NC	—	—
33	COM7	-410	-1288	83	NC	—	—
34	SEG0	-285	-1288	84	SEG32	923	1289
35	SEG1	-160	-1288	85	SEG33	798	1289
36	SEG2	-35	-1288	86	SEG34	673	1289
37	SEG3	90	-1288	87	SEG35	548	1289
38	SEG4	215	-1288	88	SEG36	423	1289
39	SEG5	340	-1288	89	SEG37	298	1289
40	SEG6	465	-1288	90	SEG38	173	1289
41	SEG7	590	-1288	91	SEG39	48	1289
42	SEG8	715	-1288	92	SEG40	-76	1289
43	SEG9	840	-1288	93	SEG41	-201	1289
44	SEG10	965	-1288	94	SEG42	-326	1289
45	SEG11	1090	-1288	95	SEG43	-451	1289
46	SEG12	1215	-1288	96	SEG44	-576	1289
47	NC	—	—	97	SEG45	-701	1289
48	NC	—	—	93	SEG46	-826	1289
49	NC	—	—	99	SEG47	-951	1289
50	NC	—	—	100	NC	—	—